

中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號：460110

[44]中華民國 90年(2001) 10月11日

新型

全 4 頁

[51] Int.Cl. 06: H05K7/20

H05K7/12

[54]名稱：電腦中央處理器散熱結構

[21]申請案號：089204275

[22]申請日期：中華民國 89年(2000) 03月17日

[72]創作人：

魏文珍

台北縣八里鄉中山路十九之四號

[71]申請人：

魏文珍

台北縣八里鄉中山路十九之四號

[74]代理人：

1

2

[57]申請專利範圍：

一種電腦中央處理器散熱結構，主要係在於散熱片可前後卡扣組合成複數散熱片組，其特徵在於：上述散熱片在上、下兩端緣水平延伸設置卡槽與卡勾，並在下端沿直角折設有導熱翼片，其中，該卡槽係自散熱片本體延接兩支腳而概呈反C型，卡槽延伸之寬度與導熱翼片同寬，且卡槽自中央處再向前延伸形成卡勾，該卡勾為一凸片而概呈波浪凹折狀，卡勾之寬度略小於卡槽之槽孔，使可嵌扣於槽孔，俾供散熱片得以前後對應扣合而形成溝狀排列之導流散

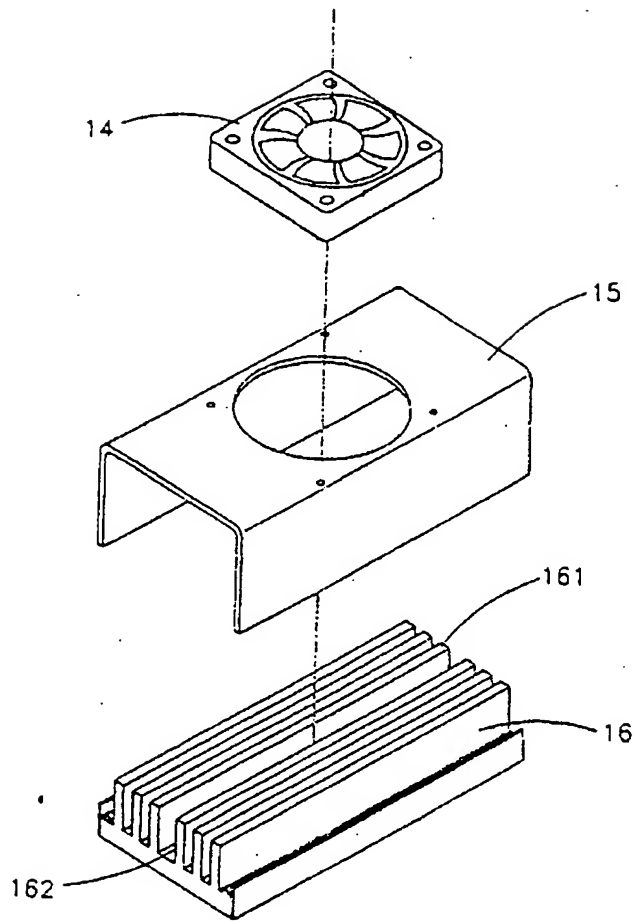
熱區，同時底部之導熱翼片靠合併成綿密之導熱接觸面，而與底板熱源之吸熱面積完全接觸者。

圖式簡單說明：

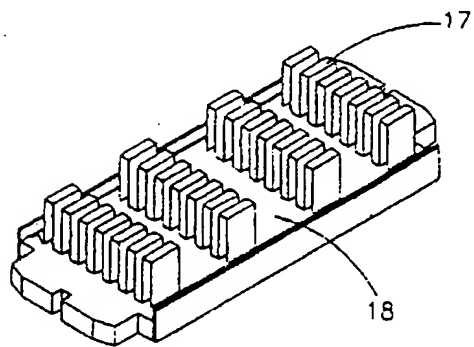
5. 第一圖係習知散熱裝置之立體圖。
- 第二圖係習知另一散熱裝置之立體圖。
- 第三圖係本創作之組合關係圖。
- 第四圖係本創作散熱片之立體組合圖。
10. 第五圖係本創作散熱片組合底部示意圖。

BEST AVAILABLE COPY

(2)



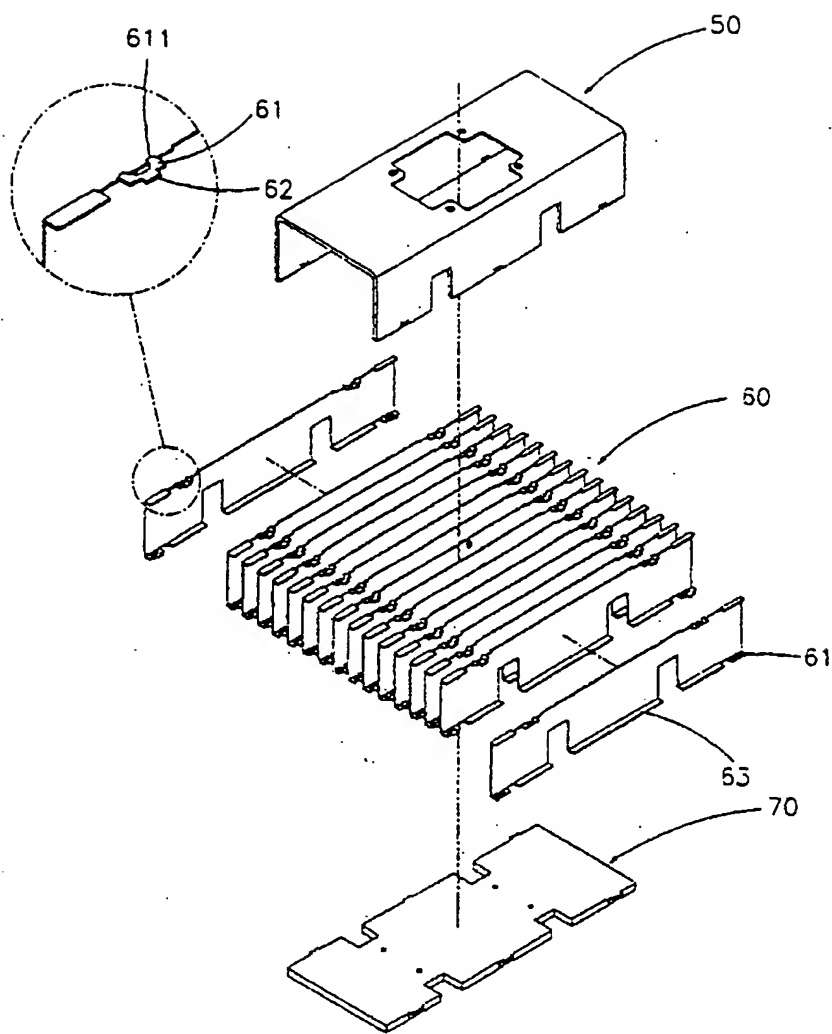
第一圖



第二圖

BEST AVAILABLE COPY

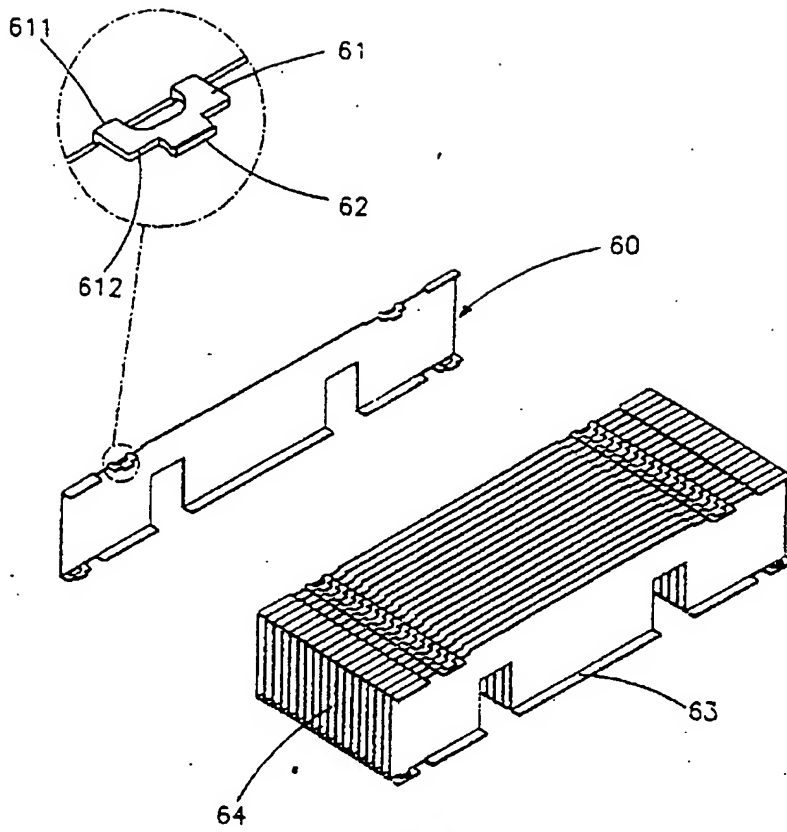
(3)



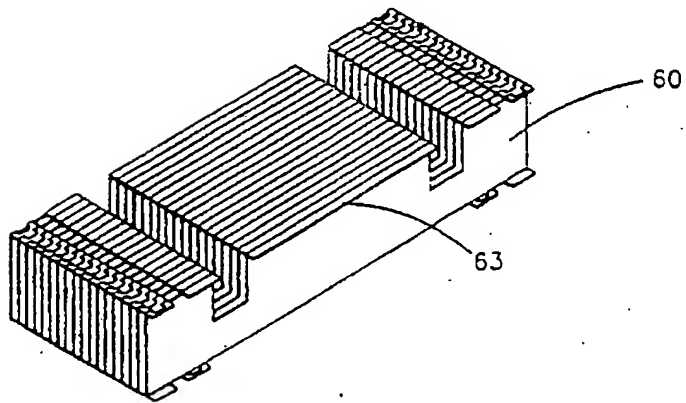
第三圖

BEST AVAILABLE COPY

(4)



第四圖



第五圖

BEST AVAILABLE COPY